PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-190001

(43)Date of publication of application: 21.07.1998

(51)Int.CI.

H01L 29/786

CO9K 3/00 H01L 21/336

(21)Application number: 09-331398

(71)Applicant: LUCENT TECHNOL INC

(22)Date of filing:

02.12.1997

(72)Inventor: BAO ZHENAN

DODABALAPUR ANANTH

FENG YI

RAJU VENKATARAM REDDY

(30)Priority

Priority number: 96 770535

Priority date: 20.12.1996

Priority country: US

(54) MANUFACTURE OF ORGANIC THIN FILM TRANSISTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form an organic semiconductor layer by forming an active layer of organic material and permitting the layer to have a carrier mobility of a specific value or higher and a conductivity of a specific value or lower.

SOLUTION: An active semiconductor layer is formed of organic polymer having a carrier mobility of approximately 10-3cm2/Vs or higher and a conductivity of approximately 10-5s/cm or lower. An organic material active layer is composed of regionegular homopolymer (3-alkylthiophene). The alkyl group has at least 2-12 carbon atoms and is represented by a character R. Branched chains, such as isopropyl and isobutyl, and straight chain alkyl are the examples of the alkyl group. In the regionegular homopolymer of the 3-alkylthiophene monomer, the orientation of the alkl group of the thiophene part is regular in regard to the thiophene part which adjoins the polymer chain.



LEGAL STATUS.

[Date of request for examination]

05.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of

07.05.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(43)公開日 平成10年(1998) 7月21日

(51) Int.Cl.*	識別記号	F I	
H01L	29/786	HOlL	29/78 6 1 7 T
C09K	3/00	C09K	3/00 R
H01L	21/336	H01L	29/78 6 1 8 Z

審査請求 未請求 請求項の数23 OL (全 7 頁)

		審査爾求	未請求 請求項の数23 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顧平9-331398	(71)出顧人	596077259 ルーセント テクノロジーズ インコーポ
(22)出顧日	平成9年(1997)12月2日		レイテッド Lucent Technologies
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	08/770535 1996年12月20日 米国(US)		Inc. アメリカ合衆国 07974 ニュージャージ ー、マレーヒル、マウンテン アベニュー 600-700
		(74)代理人	弁理士 三俣 弘文

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機薄膜トランジスタの製造方法

(57)【要約】

()

【課題】 活性層が有機材料であって、そのキャリア移動度が10-3cm3/Vs以上であり、伝導度が約10-3S/cm以下であるような、半導体薄膜トランジスタ(TFT)を実現する。

【解決手段】 有機半導体材料は、3-アルキルチオフェンモノマーのホモポリマーである。このホモポリマーは位置規則的(regioregular)構造を有し、チオフェン部分のアルキル基(R基)の配向は、ポリマー鎖上で隣接するチオフェン部分に関して規則的である。すなわち、ポリマーバックボーンにおいて2つの隣接するチオフェン部分に対して、ただ1個のアルキル基がこれらの2つのチオフェン部分の間の空間に配向するように、チオフェン部分のアルキル基は配置される。ポリマー中のほとんどのチオフェン部分はこの「規則的」配向のアルキル基を有する。

$$-\sqrt{s}$$

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にゲート電極を形成するステップと、

前記基板上に絶縁材料層を形成するステップと、

有機材料と溶媒からなる溶液を前記絶縁材料層の上に塗布して有機材料活性層を形成するステップと、

前記有機材料活性層に接触してソース電極およびドレイン電極を形成するステップとからなる、有機薄膜トランジスタの製造方法において、

前記有機材料活性層のキャリア移動度は約10-2cm2/Vs以上であることを特徴とする、有機薄膜トランジスタの製造方法。

【請求項2】 前記有機材料活性層は位置規則的ポリ (3-アルキルチオフェン)からなることを特徴とする 請求項1の方法。

【請求項3】 位置規則的ポリ(3-アルキルチオフェン)は、

【化1】

および 【化2】

からなる群から選択される構造を有することを特徴とする請求項2の方法。

【請求項4】 Rは置換アルキル基または非置換アルキル基であることを特徴とする請求項3の方法。

【請求項5】 アルキル基は2~12個の炭素原子を有することを特徴とする請求項4の方法。

【請求項6】 前記溶媒は塩素化有機溶媒からなることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項7】 前記塩素化有機溶媒はクロロホルムであることを特徴とする請求項6の方法。

【請求項8】 前記溶液は前記絶縁材料層上にプリント されることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項9】 前記絶縁材料層は、ポリイミド、ポリエステル、およびポリメチルメタクリレートからなる群から選択されることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項10】 前記絶縁材料層は前記基板上にプリントされることを特徴とする請求項9の方法。

【請求項11】 基板上にゲート電極を形成するステップと.

前記基板上に絶縁材料層をプリントするステップと、 有機材料と溶媒からなる溶液を前記絶縁材料層の上にプリントして有機材料活性層を形成するステップと、 前記有機材料活性層に接触してソース電極およびドレイ

ン電極を形成するステップとからなる、有機薄膜トラン ジスタの製造方法において、

前記有機材料活性層のキャリア移動度は約10⁻¹cm¹ /Vs以上であることを特徴とする、有機薄膜トランジスタの製造方法。

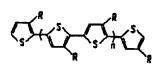
【請求項12】 前記有機材料活性層は位置規則的ポリ(3-アルキルチオフェン)からなることを特徴とする請求項11の方法。

) 【請求項 1 3 】 位置規則的ポリ(3 - アルキルチオフェン)は、

[1k3]

および 【化4】

20



からなる群から選択される構造を有することを特徴とする請求項12の方法。

【請求項14】 Rは置換アルキル基または非置換アルキル基であることを特徴とする請求項13の方法。

【請求項15】 アルキル基は2~12個の炭素原子を有することを特徴とする請求項14の方法。

【請求項16】 前記溶媒は塩素化有機溶媒からなると とを特徴とする請求項11の方法。

30 【請求項17】 前記塩素化有機溶媒はクロロホルムであることを特徴とする請求項16の方法。

【請求項18】 前記絶縁材料層は、ボリイミド、ボリエステル、およびボリメチルメタクリレートからなる群から選択されることを特徴とする請求項11の方法。

【請求項19】 基板(110)上のゲート電極(13 0)と、

前記基板上の絶縁材料層(120)と、

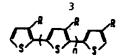
前記絶縁材料層上の位置規則的ポリ(3-アルキルチオフェン)活性層(150)と、

40 前記位置規則的ポリ(3-アルキルチオフェン)活性層 に接触するソース電極およびドレイン電極(140, 150)とからなる薄膜トランジスタ(100)において

前記位置規則的ポリ(3-アルキルチオフェン)は基板表面に平行に配向したポリマーバックボーンを有し、前記活性層のキャリア移動度は約10-2cm2/Vs以上であることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項20】 位置規則的ポリ(3-アルキルチオフェン)は、

50 【化5】



および [116]

からなる群から選択される構造を有することを特徴とす 10 る請求項19の薄膜トランジスタ。

【請求項21】 Rは置換アルキル基または非置換アル キル基であることを特徴とする請求項20の薄膜トラン ジスタ。

【請求項22】 アルキル基は2~12個の炭素原子を 有することを特徴とする請求項21の薄膜トランジス

【請求項23】 前記絶縁材料層は、ポリイミド、ポリ エステル、およびポリメチルメタクリレートからなる群 から選択されるととを特徴とする請求項19の薄膜トラ 20 ンジスタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機材料の活性層 を含む薄膜トランジスタ(TFT)、および、そのよう なトランジスタの製造方法に関する。

[0002]

()

【従来の技術】最近、薄膜電界効果トランジスタ (FE T) 内の活性半導体層として使用するために有機材料が 検討されている。有機材料は加工が容易であり、一般に 薄膜FETが形成されるプラスチック基板と親和性が髙 いので、薄膜デバイス内の活性半導体層としての使用は 魅力的である。このような長所は、低コストで大面積の デバイスを製造する際に重要である。有機半導体が薄膜 FET内の活性半導体層として使用されるためには、結 果として得られるデバイスのオン/オフ比が受け入れら れるものでなければならない。一般に、薄膜FETのオ ン/オフ比は少なくとも10'でなければならない。こ こで使用するオン/オフ比という用語は、トランジスタ がオンであるときのソース - ドレイン電流の、トランジ 40 スタがオフであるときのソース-ドレイン電流に対する 比のことである。

【0003】有機半導体材料が活性半導体層としての使 用に適しているかどうかを示す有機半導体材料の性質 は、キャリア移動度および(電気)伝導率である。キャ リア移動度(µ)は、半導体材料の層内での粒子(例え ば、電子、正孔)の平均のドリフト速度の尺度であり、 このような粒子の運動が、加えられる電界によってどの くらい強く影響を受けるかを決定するため重要である。 伝導率 (σ) は、半導体材料層が電荷を伝導する能力を 50 ier, F., et al., "All-Polymer Field-Effect Transist

記述する。伝導度は次式によってキャリア移動度と関連 づけられる。

 $\sigma = q p \mu$

ただし、pはキャリア密度であり、qは電気素量であ る。キャリア移動度が約10-3cm2/Vs(センチメ ートル²/ボルト・秒)以上で伝導度が約10⁻¹S/c m (ジーメンス/センチメートル)以下の有機半導体材 料は、薄膜FET内の活性半導体層として有用な可能性 がある。このような性質の活性半導体層を有するFET は少なくとも約103のオン/オフ比を有するであろ

【0004】有機薄膜トランジスタ(TFT)デバイス を製造する方法として、電気化学重合、溶液塗布および 真空堆積という3つの方法が用いられている。Tsumura. A., et al., "Macromolecular electronic device: Fie 1d-effect transistor witha polythiophene thin fil m", Appl. Phys. Lett., vol.49 (18), pp.1210-1212 (1986)、には、2, 2'-ビチオフェンと過塩素酸テト ラエチルアンモニウム電解質をアセトニトリル溶液中で 100μA/cm² (マイクロアンペア/センチメート ル」)の定電流で電気化学重合して半導体有機高分子 (ポリマー)を形成することが記載されている。このよ うな電気化学重合を用いて形成される有機ポリマーは、 キャリア移動度が約10⁻, c m²/V s のポリチオフェ ン化合物であり、薄膜FETで使用する材料としては不 満足である。

[0005] Assadi, A., et al., "Field-effect mobi lity of poly(3-hexylthiophene)",Appl. Phys. Lett., vol.53 (3), pp.195-197 (1988)、には、ポリ(3-ヘ 30 キシルチオフェン)をクロロホルムに濃度1mg/ml で溶解した後に基板上にスピンコートしてアモルファス のポリ(3-アルキルチオフェン)半導体高分子膜を形 成することが記載されている。形成される有機ポリマー は、キャリア移動度が約10-, c m3/V s ~ 10-, c m²/Vsのポリ(3-ヘキシルチオフェン) 膜であ り、薄膜デバイスで使用する材料としては不満足であ

[0006] Fuchigami, H., et al., "Polythienylene vinylene thin-film transistor with high carrier mo bility", Appl. Phys. Lett., vol.63 (10), pp.1372-1 374(1993)、には、ポリチエニレンビニレン半導体膜を ポリマーの可溶性プリカーサ (前駆体) から形成すると とが記載されている。プリカーサポリマーを溶液から堆 積した後、化学反応によって半導体ポリマーに変換す る。この2ステップのFuchigami et al.のプロセスを用 いて形成される有機半導体ポリマーのキャリア移動度は 約10⁻'cm'/Vsである。

【0007】オリゴチオフェンのようなオリゴマーの真 空堆積によって形成される有機半導体ポリマーが、Garn or Realized by Printing Techniques", Science, vol. 265, pp.1684–1686 (1994)、 に記載されている。 真空堆 積によって形成される有機半導体ポリマーのキャリア移動度は約 10^{-2} cm $^2/V$ s である。 しかし、 Garnier e t al. に記載されているプロセスは高価な蒸発装置を用いているので、低コスト薄膜FETを製造するためにとのようなプロセスを利用することは制限される。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従って、有機半導体層を形成するために用いられる技術がさらに求められてい 10 る。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、活性層が有機材料であって、そのキャリア移動度が10-3cm2/Vs以上であり、伝導度が約10-3S/cm以下であるような、半導体薄膜トランジスタ(TFT)の製造方法に関する。この有機半導体材料は、3-アルキルチオフェンモノマーのホモボリマーである。このホモボリマーは位置規則的(regioregular)構造を有する。

【0010】3-アルキルチオフェンモノマーの位置規 20 則的ホモポリマーでは、与えられたチオフェン部分のアルキル基(R基)の配向は、ポリマー鎖上で隣接するチオフェン部分に関して規則的である。すなわち、ポリマーバックボーンにおいて与えられた2つの隣接するチオフェン部分に対して、ただ1個のアルキル基がこれらの2つのチオフェン部分の間の空間に配向するように、チオフェン部分のアルキル基は配置される。ポリマー中のほとんどのチオフェン部分はこの「規則的」配向のアルキル基を有する。しかし、少なくとも95パーセントのチオフェン部分がこのような配向のアルキル置換基を有 30 するような位置規則的3-アルキルチオフェンポリマーであれば適当であると考えられる。

【0011】本発明の一実施例では、TFTは、有機半導体材料の活性層を有する金属 - 絶縁体 - 半導体電界効果トランジスタ(MIS-FET)である。このTFTは、ガラス、シリコン、あるいはプラスチックのような従来の基板材料上に形成される。絶縁材料の層は、スピンコート、鋳込成形あるいはスクリーンブリントなどのさまざまな技術を用いて基板上に形成される。絶縁材料という用語は、伝導度が約10⁻¹²S/cm以下の材料をいう。活性層は絶縁層上に形成される。

【0012】一般に、デバイスは、離間した3個の接点を有する。これらの接点のうちの少なくとも2個は、有機半導体層と物理的に接触し、このような半導体層の少なくとも一部を通る電流路を有する。第3の接点は、基板と物理的に接触し、第1の接点と第2の接点の間に位置する半導体層を通る電流を制御する。接点は金属からなる。MIS-FETデバイスにおける接点として用いられる金属は従来どおりであり、当業者に周知である。適当な金属の一例は金である。

【0013】本発明のプロセスにおいて、活性半導体層は、有機材料と溶媒からなる溶液を絶縁材料の層の上に塗布することによって形成される。有機材料と溶媒の溶液は、スピンコート、鋳込成形およびプリントなどのさまざまな技術を用いて塗布される。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明は、活性半導体層を有する TFTデバイスの製造方法に関する。活性半導体層は、 キャリア移動度が約10⁻³ c m²/V s 以上で伝導度が 約10⁻³ S / c m以下の有機ポリマーである。本発明の プロセスによって製造されるデバイスの20℃でのオン /オフ比は約10³以上である。

【0015】図1に、TFTの活性半導体層として用いられる3-アルキルチオフェンモノマーの位置規則的ホモボリマーを示す。アルキル基は少なくとも2~12個の炭素原子を有し、図1および図2では文字Rで一般的に表している。このアルキル基の例としては、イソブロビルやイソブチルのような分岐鎖や、直鎖アルキルがある。アルキル基は、置換されていても置換されていなくてもよい。置換されている場合、適当な置換基の例としては、カルボン酸、スルホン酸、およびチオールがある。

【0016】3-アルキルチオフェンモノマーの位置規 則的ホモポリマーでは、チオフェン部分のアルキル基の 配向は、ポリマー鎖の隣接するチオフェン部分に関して 規則的である。すなわち、ポリマーバックボーンにおい て与えられた2つの隣接するチオフェン部分に対して、 ただ1個のアルキル基がこれらの2つのチオフェン部分 の間の空間に配向する。2つの異なる位置規則的ポリ (3-アルキルチオフェン) 構造をそれぞれ図1および 図2に示す。図1の構造では、チオフェン部分はポリマ ーバックボーンに対して一定の配向である。その結果、 図1のR基はポリマー鎖の片側にある。図2の構造で は、鎖中のチオフェン部分の配向はポリマーバックボー ンに対して第1の配向と第2の配向の間で交互になって いる。第1配向のチオフェン部分のR基はポリマーバッ クボーンの第1の側にある。第2配向のチオフェン部分 のR基はポリマーバックボーンの第1の側とは反対の側 にある。図1および図2に示したポリマー内のR基の位 40 置は規則的であるため、位置規則的(regioregular)とい う。ポリマーバックボーンを構成するチオフェン部分の R基のこのような位置規則的配向のことを以下ではHT (head-to-tail)連結という。一般に、3-アルキルチオ フェンモノマーのホモポリマーは少なくとも95%のH T連結を有し、ポリマー鎖中の少数のチオフェン部分 (約5%以下)は、位置規則的配向に従わない配向を有 する。

【0017】図3に、本発明のプロセスを用いて形成される金属-絶縁体-半導体(MIS)FET型のデバイ 50 スの例を示す。MISFET100は基板110を有 し、その上に、絶縁材料層120および金属接点130 が形成される。さらに2つの金属接点140および15 0が、絶縁材料層上に形成される。有機半導体材料層1 60が、接点140および150の上およびそれらの間 に形成される。 (MISFETの別の例(図4)では、 金属接点130は基板と絶縁材料層120の間に形成さ れ、金属接点140および150は有機半導体材料層1 60の上に形成される。)

【0018】基板110は、シリコン、ガラス、あるい 0、140、150は、金、インジウムスズ酸化物(I TO)、導電性インク、あるいは導電性ポリマーのよう なこの目的のための従来の材料からなる。接点130、 140、150は従来の周知の方法を用いて形成され、 ここでは詳細には説明しない。

【0019】一実施例では、絶縁材料層120は有機材 料である。有機絶縁材料の例には、ポリイミド、ポリエ ステル、およびポリメチルメタクリレート(PMMA) がある。絶縁材料層は、有機絶縁材料を基板表面上に鋳 込成形、スピンコートあるいはプリントすることによっ 20 て形成される。一実施例では、絶縁材料はスクリーンマ スクを用いて基板上にブリントされる。スクリーンマス クは、1インチあたり400メッシュカウントで乳剤の 厚さが約7.5マイクロメートル (μm) のステンレス スチール織布からなる。有機材料をステンレススチール 織布に塗布し、スクイージー(ドクターブレード)を用 いてスクリーンの開口を通して有機材料を基板表面上に 押し出す。このようなスクリーンプリントを用いて形成 される絶縁材料の厚さは約0.1マイクロメートル(μ m) ~ 1 . 0 マイクロメートル (μm) である。一般 に、絶縁材料のキャパシタンスは約10-8F/cm '(ファラド/平方センチメートル)とする。別法とし て、絶縁材料層は、二酸化シリコン、窒化シリコン(S i, N,)、あるいは酸化アルミニウム (A 1, O,) のよ うな無機材料から、従来技術で周知の方法を用いて形成 することも可能である。

【0020】活性有機半導体材料層160は、位置規則 的有機ポリマーと適当な溶媒の溶液を、スピンコート、 鋳込成形、あるいはプリントのような従来の方法を用い て塗布することによって形成される。例えば、位置規則 40 露した。 的ポリ(3-アルキルチオフェン)化合物は、クロロホ ルム、塩化メチレン、クロロベンゼン、およびテトラク ロロエチレンのような塩素化有機溶媒に可溶である。沈 殿したポリマーを含む溶液から形成した膜には不連続が 生じるので、有機ポリマーは溶媒に完全に溶解すること が望ましい。有機半導体材料層160の厚さは少なくと

()

も300Aである。

【0021】例として、図3のMISFETのようなM IS-FET型TFTは、nドーブしたシリコン基板1 10上にチャネル長12μm、ゲート長250μmで形 成される。厚さ3000Aの二酸化シリコン(Si O,)層が基板110上に形成される。絶縁材料層12 0は、キャパシタンスが約10nF/cm²(ナノファ ラド/平方センチメートル) のSiO,層である。2つ の別々の金接点140、150が絶縁材料層120の上 はプラスチックのような従来の材料からなる。接点13 10 に形成される。第3の接点はシリコン基板110上に直 接形成される。ポリ(3-アルキルチオフェン)層が絶 縁材料層120の上に形成され、その上に接点140、 150が形成される。

[0022]

【実施例】位置規則的なポリ(3-ヘキシルチオフェ ン) (PHT)、ポリ(3-オクチルチオフェン) (P OT) およびポリ (3-ドデシルチオフェン) (PD T)を、Aldrich Chemical Companyから入手した。これ らのポリマーにおける連結は、少なくとも98.5%が HT連結であった。ポリマーの平均分子量は25,00 0以上であり、多分散度(polydispersity)は約1.5で あった。これらのポリマーをトルエンに溶解してアセト ンから沈殿させることにより精製した。精製を全部で3 回実行した後、アセトンで抽出した。

【0023】それぞれの位置規則的ポリ(3-アルキル チオフェン) (0.01g/m1)を室温でクロロホル ムに溶解し、孔径0. 200μmのポリテトラフルオロ エチレン (PTFE) メンプランシリンジフィルタで濾

【0024】上記の位置規則的ポリ(3-アルキルチオ 30 フェン) 化合物を活性層として用いて、図3に関して上 記で一般的に説明したようにして、デバイスを形成し た。溶解したポリマーを含む溶液を鋳込成形によって絶 縁層上に塗布した。結果として得られた膜の厚さは溶液 の濃度に依存した。との基板を真空環境で24時間乾燥 させた。さらに、一部の基板については、窒素(N₂) ガスを水酸化アンモニウム水溶液中で発泡させた容器内 にこの基板を入れることによって、ポリ(3-アルキル チオフェン)を気体アンモニア(NH,)に10時間暴

【0025】上記のようにして調整した膜のキャリア移 動度および伝導度を以下の表1にまとめる。これらの膜 から製造したデバイスのオン/オフ比も示す。

[0026]

【表1】

9	膜のキャリア移動度 (cm²/Vs)	膜の伝導度 (S/cm)	10 デバイスの オン/オフ比
PHT	$1.0 - 3.9 \times 10^{-2}$	$3 \times 10^{-5} - 1.5 \times 10^{-4}$	100 - 400
PHT (NH3暴露)*	$1.0 - 2.1 \times 10^{-2}$	$3 \times 10^{-7} - 1.5 \times 10^{-6}$	1000 - 9000
POT	$1.0 - 2.5 \times 10^{-2}$	$1.5 \times 10^{-5} - 7.5 \times 10^{-5}$	10 - 60
PDT	$2 \times 10^{-6} - 10^{-4}$	$4 \times 10^{-9} - 2 \times 10^{-7}$	10 - 30

*PHT膜を鋳込成形により塗布した後、基板を真空環 境で乾燥させ、NH」に暴露した。

【0027】表1にまとめたキャリア移動度、伝導度、 に少なくとも2つの基板を用いて形成したデバイスで測 定した。例えば、ヘキシル置換基を有する半導体有機ポ リマー層を10個の基板上に形成し、少なくとも20個 のデバイスを各基板上に形成した。

【0028】表1にまとめたキャリア移動度μは次式を 用いて計算した。

 $I_{os} = (WC_1/2L) \mu (V_6 - V_o)^2$

ただし、Wはチャネル幅 (250μm)、Lはチャネル 長(12 µm)、および、C,は絶縁材料層の単位面積 あたりのキャパシタンス (10nF/cm²) である。 上記の式を用いてキャリア移動度μを計算するため、飽 和領域におけるドレイン-ソース電流(І。。)の平方根 と、デバイスのゲート電圧 (V_c) の間の関係から、測 定値から I ps = 0 へ外挿することによって、見かけのし きい値電圧(V。)が決定される。飽和領域における I osは、与えられたV。におけるドレイン-ソース電圧 (Vըς) とドレイン-ソース電流の間の関係を観測する ことによって決定される。飽和領域における Ios とは、 ドレイン-ソース電圧を上げても I。sがもはや増大しな いときのIosである。飽和領域におけるIosはVoとと もに変動する。V。を決定するこの方法は従来のもので あり、当業者には周知である。

【0029】伝導度は次式から決定した。 $\sigma = C_1 V_0 \mu / d$

ただし、C,は絶縁層のキャパシタンス、V。は見かけの しきい値電圧、μはキャリア移動度、および、dは半導 体ポリマー膜の厚さである。

【0030】オン/オフ比は、ゲート電圧(Va)がド レイン電圧(V。)以上であるときに飽和状態で流れる ドレイン電流の、V。がOのときに流れるドレイン電流 に対する比である。例えば、V。およびV。がいずれも一 100 Vのとき I_{os} が 9×10^{-6} Aで、 $V_{o} = 0$ かつ V_{o} =-100Vのとき lpsが l×10-0Aである場合、デ バイスのオン/オフ比は9×10³である。

【0031】発明者は特定の理論にこだわるものではな いが、デバイスの性能はポリ(3-アルキルチオフェ ン) 膜の形態(モルフォロジー) に関連していると考え られる。表1に列挙した位置規則的ポリ(3-ヘキシル

チオフェン) 膜のX線回折分析を図5に示す。これによ れば、非常に強く鋭い1次回折ピークが5.4°にあ り、2次回折ピークは10.8°、3次回折ピークは1 およびオン/オフ比の値の範囲は、角半導体材料層ごと 10 6.3° にあり、16.36 Aの分子間間隔に対応する (グラフ参照)。 このような分子間間隔は、アルキル基 によって離間された、チオフェン鎖の層の(基板面に平 行な)平面状積層を提供する。とのようにして、チオフ ェンポリマーバックボーンは一般に基板表面に平行とな

> 【0032】同じ位置規則的ポリ(3-ヘキシルチオフ ェン)膜に対して実行した電子回折分析も図5に示して ある。電子回折は約3.7~3.8人に主要なピークを 示しており、これは、隣接する鎖中の積層したチオフェ 20 ン環の間の距離に対応する。チオフェン環間隔に対する このような値は、ヘキシル基が基板の表面にほぼ垂直に 配向し、積層したチオフェン鎖の方向が基板に平行であ るという好ましい配向を示している。

[0033]

【発明の効果】以上述べたどとく、本発明によれば、活 性層が有機材料であって、そのキャリア移動度が10-3 cm²/Vs以上であり、伝導度が約10-3S/cm以 下であるような、半導体薄膜トランジスタ (TFT) が 実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】HT (head-to-tail)連結の配位規則的構造を含 むポリ(3-アルキルチオフェン)化合物の構造の図で ある。

【図2】図1に示した配位規則的構造に相補的なHT連 結の図である。

【図3】本発明のプロセスを用いて形成される金属-絶 縁体-半導体(MIS)FETの図である。

【図4】図3のMISFETの変形例の図である。

【図5】ポリ(3-ヘキシルチオフェン)層のX線回折 40 および電子回折分析の図である。

【符号の説明】

100 MISFET

110 基板

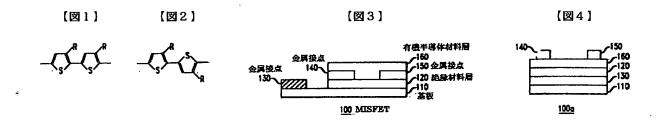
120 絶縁材料層

130 金属接点

140 金属接点

150 金属接点

160 有機半導体材料層



50 10⁵ 20⁵ 500

【図5】

フロントページの続き

(71)出願人 596077259

600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Je rsey 07974-0636U.S.A.

(72)発明者 ゼナン バオ

()

アメリカ合衆国、07060 ニュージャージ ー、ノース プレインフィールド、ロック アベニュー 1275、アパートメント ジ ェイジェイ8 (72)発明者 アナンス ドダバラバー

アメリカ合衆国、07946 ニュージャージ ー、ミリントン、ヒルトップ ロード 62

(72)発明者 イ フェン

アメリカ合衆国、44321 オハイオ、コー プリー、コブルストーン ドライブ 4343

(72)発明者 ベンカタラム レディ ラジュ

アメリカ合衆国、07974 ニュージャージ ー、ニュー プロビデンス、プリンストン ドライブ 49

THIS PAGE BLANK (USPTO)